

证券代码：603061

证券简称：金海通

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场访谈 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 线上分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 线上调研
参与单位名称	景顺长城、华夏基金、南京证券自营、理臻投资、浙商基金、银河基金、创金合信基金、湘财基金、青骊投资、广东吉翱私募、东方红资产管理、中泰证券、永赢基金、长城基金、中邮证券（以上排名不分先后） 业绩说明会：参与业绩说明会的投资者	
时间	2025年3月26日至2025年3月28日	
地点	路演：上海市浦东新区花木路1388号 业绩说明会：上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）	
上市公司接待人员姓名	特定对象调研、路演活动：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生； 业绩说明会：董事长、总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士。	
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司介绍主要内容</b></p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生</p>	

产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

## 二、公司 2024 年经营情况介绍

2024 年，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域企稳复苏。受益于部分客户所处细分领域的需求增长、部分区域市场及客户实现突破、高配置系列产品占比提升等因素影响，公司 2024 年实现营业收入 4.07 亿元，较上年增长 17.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,848.15 万元，较上年减少 7.44%。2024 年末，公司总资产为 15.99 亿元，较上年末增长 0.86%；2024 年末，公司归属于上市公司股东的净资产为 13.16 亿元，较上年末下降 5.91%。

产品方面，2024 年，公司持续跟进客户需求，对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司测试分选机新增 PD（局部放电）测试、串测、Near short（接近短路）以及测试芯片极端发热条件下的热管理测试等测试分选功能，对产品进行持续升级。

2024 年，公司 EXCEED-9800 系列三温测试分选机实现量产，针对于效率要求更高的大规模、复杂测试需求，公司持续对 EXCEED-9032 系列大平台分选机进行升级。

公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，公司持续加大市场推广力度，继续提升海外市场服务能力，深化客户服务。公司 2024 年销售费用较上年同期增长 41.35%，公司积极拓展新客户，与客户保持紧密沟通，积极参加展会等行业相关活动。2024 年，公司扎实推进“马来西亚生产运营中心”项目建设并于 2025 年 2 月正式启用。公司“马来西亚生产运营中心”助力公司更好地贴近市场和客户、响应客户需求。

### 三、调研问答

1、问：公司交货周期如何？

答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。

2、问：从产品结构上看，2024 年，EXCEED-9000 系列产品占收入比重的情况如何？

答：2024 年，公司 EXCEED-9000 系列产品（EXCEED-9800 系列、EXCEED-9032 系列）收入比重提升至 25.80%，2023 年为 11.45%。

3、问：对行业复苏的感知如何？

答：2024 年，半导体行业下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域行业企稳复苏。新能源、电动汽车及 AI 运算等相关产业的发展在一定程度上助推了半导体封装测试设备领域的发展。

4、问：2024 年在产品研发方面有什么进展？

答：一方面，是对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2024 年，公司测试分选机新增 PD（局部放电）测试、串测、Near short（接近短路）以及测试芯片极端发热条件下的热管理测试等测试分选功能；针对于效率要求更高的大规模、复杂测试需求，公司持续对 EXCEED-9032 系列大平台分选机进行升级；适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证；同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的

测试分选需求。

5、问：马来西亚工厂的进展如何？

答：2024年，公司扎实推进“马来西亚生产运营中心”项目建设并于2025年2月正式启用。公司“马来西亚生产运营中心”助力公司更好地贴近市场和客户、响应客户需求。

#### 四、业绩说明会问答

1、问：国际贸易摩擦加剧背景下，公司在供应链安全和海外市场拓展上有何双重应对策略？是否建立替代供应商清单？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司生产所需主要原材料主要为国内供应商、代理商或贸易商提供，其中部分涉及进口品牌，但主要生产地在中国大陆，同时，上述原材料能找到提供同类产品的国产厂商进行替代。

2、问：公司获得政府补助等递延收益增加，这部分资金将重点用于哪些研发或生产环节？如何评估政策支持对技术突破的推动作用？

答：2024年度，公司获得政府补助等递延收益增加，主要系公司募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”持续推进建设所致。相关政策支持将助力公司技术及产品创新。

3、请问公司如何平衡市场份额争夺与毛利率保护？是否计划推出差异化中低端产品？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域，经过多年的研发和创新，公司产品的主要技术指标及功能已达到同类产品国际先进水平。产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

公司将继续加强全球市场开拓力度，同时持续加大研发力度，在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等各方面持续升级和迭代公司产品。与此同时，公司将不断提升内部运营效率，通过优化生产流程、加强供应链管理、合理控制费用支出等方式，在确保产品质量和技术竞争力的前提下，努力降低生产成本，维持较好的毛利

	率水平。
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025年3月28日